DAXIN

達興材料股份有限公司

股票代碼：5234

法人說明會

2020.12.17

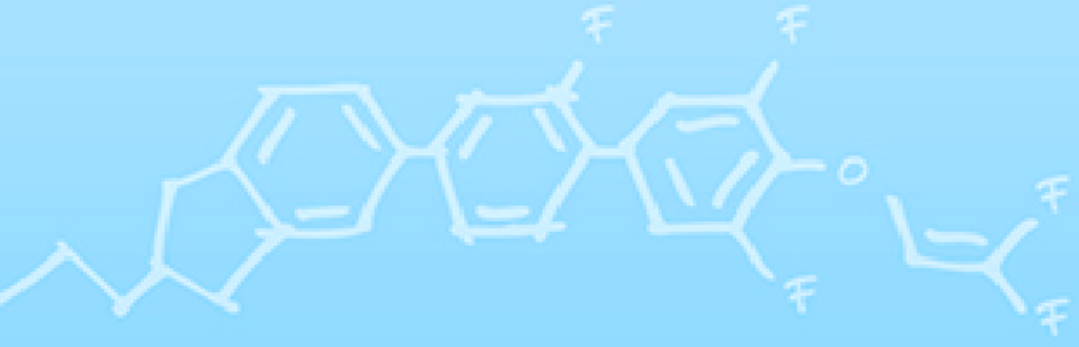
免責聲明

- 本簡報及同時發佈之相關訊息內含有從公司內部與外部來源所取得的預測性資訊。本公司未來實際所發生的營運結果、財務狀況以及業務展望，可能與這些預測性資訊所明示或暗示的預估有所差異，其原因可能來自於各種本公司所不能掌控的風險。

- 本簡報中對未來的展望，反應本公司截至目前為止對於未來的看法。對於這些看法，未來若有任何變更或調整時，本公司並不負責隨時提醒或更新。

簡報大綱

- 公司簡介
- 經營成果
- 營運概況與未來展望



公司簡介

公司基本資料

創立日期	2006年7月12日 (友達光電及長興材料合資成立)
資本額	新臺幣10.27億
員工人數	截至2020年11月之員工人數為357人 研發人員 > 50%
上市日期	2012年7月16日 (股票代號：5234)
合併營收	2019年：45.31億 2020年前11月：39.56億
主要營業項目	顯示器材料 半導體材料 上游關鍵原材料 其他特用精細化學材料

營運據點

營運總部/研發中心 – 台中中科

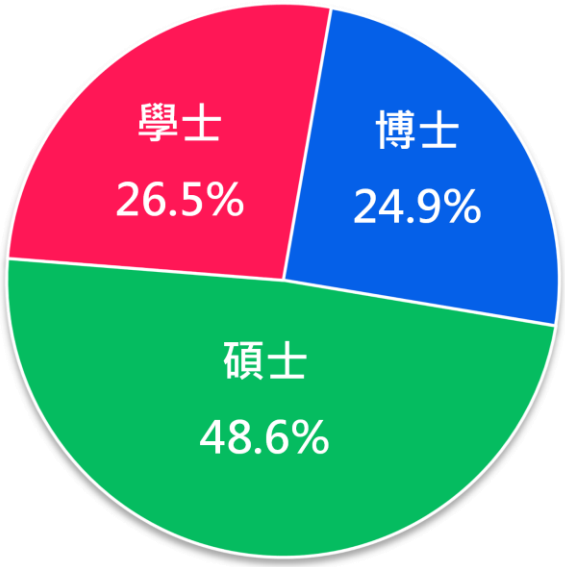
先進製造中心 I – 台中中科

先進製造中心 II – 台中中港

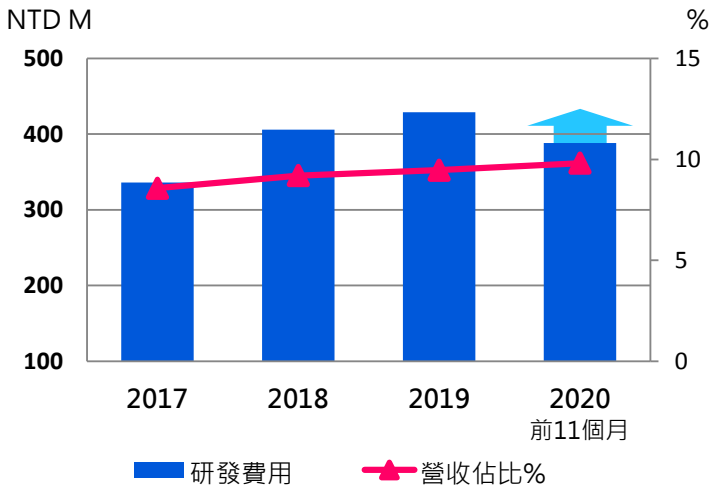
研發投入

研發人員 > 50%

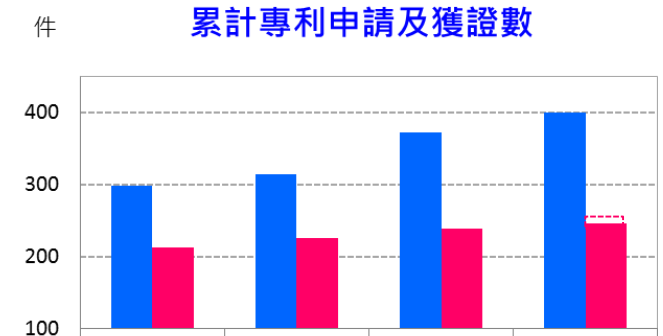
研發團隊 學歷分佈



研發佔營收10%

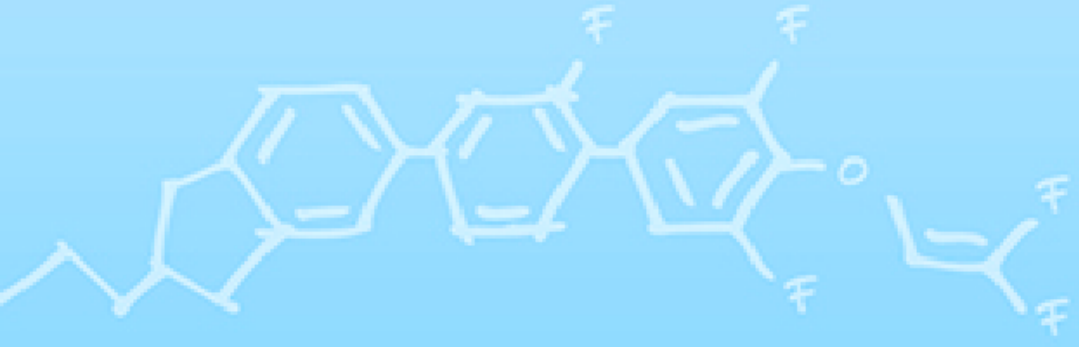


專利申請 400 件



	2017	2018	2019	2020
申請	299	315	373	400
獲證	213	226	239	246

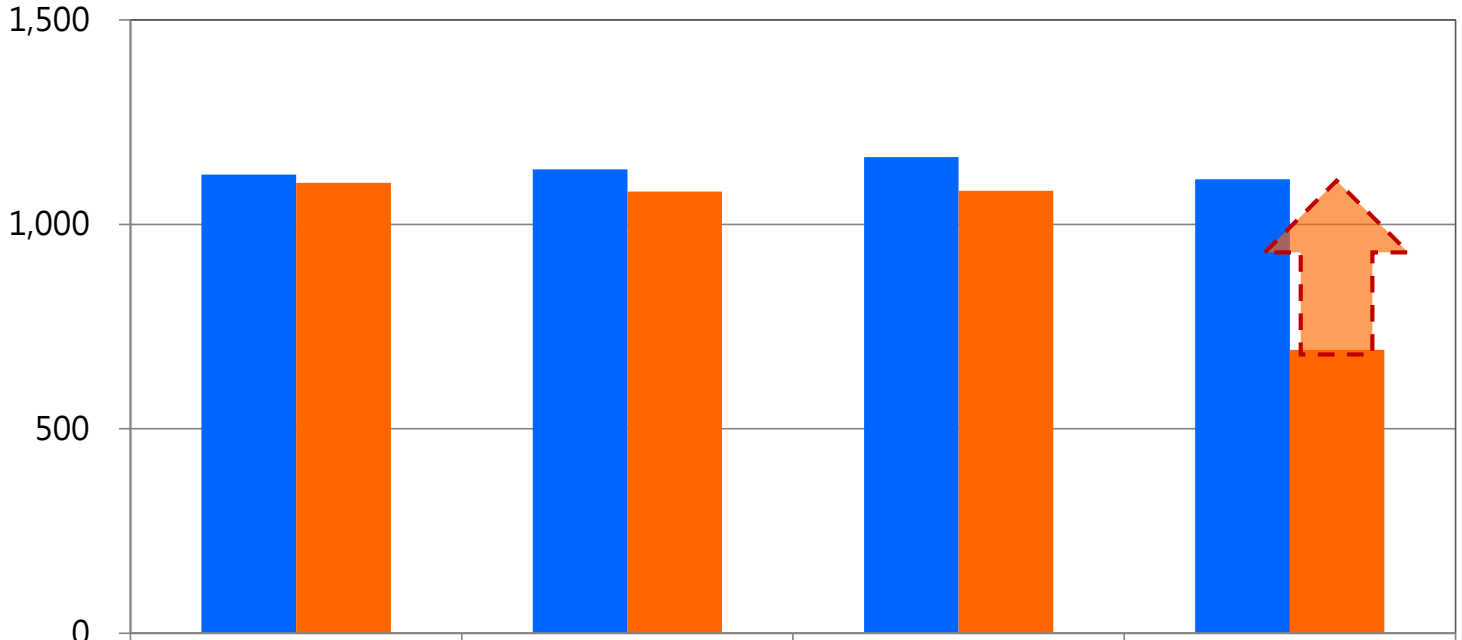
資料日期：2020.11.30



經 營 成 果

季營收額

Unit: NTD M



	Q1	Q2	Q3	Q4
2019 Sales	1,122	1,134	1,165	1,110
2020 Sales	1,101	1,080	1,082	693 (註)

◆ 2020 前11月營收 39.56億，較去年同期 41.66億，減少 5%。

註：2020 Q4 為 10~11月自結數

內外銷營收比例

	2018	2019	2020 (1-11月)
外銷	26.5%	35.3%	38.6%
內銷	73.5%	64.7%	61.4%

- 2019Y為 35.3%， 2020前3季為38.9%。
- 半導體產品目前小量出貨，貢獻仍小，為未來營收重要成長動能。

合併綜合損益表(季)

Unit：NTD M

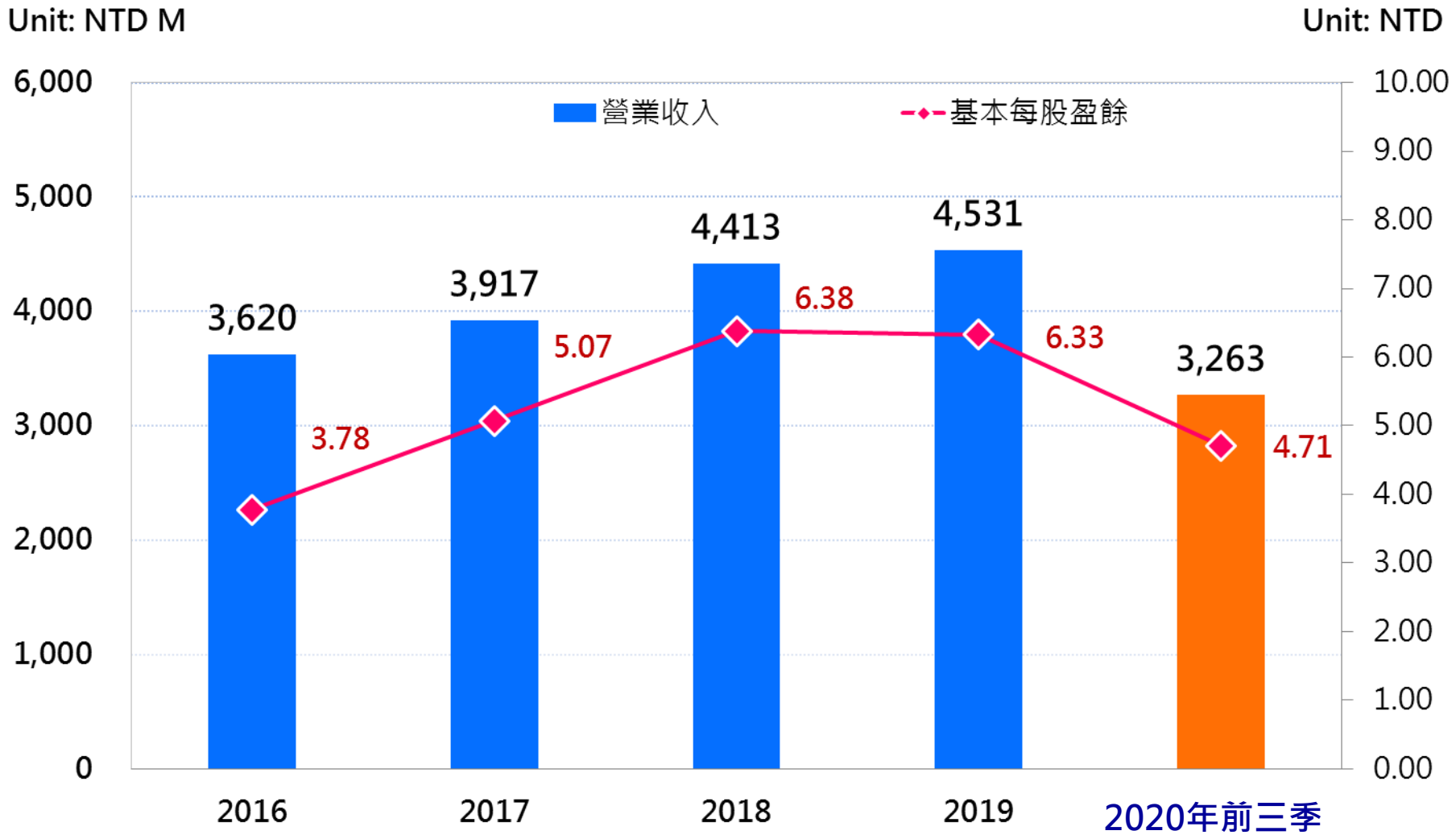
	2020 Q3		2020 Q2		季成長%	2019 Q3		年成長%
營業收入	**1,082**	**100.0%**	**1,080**	**100.0%**	**0.2%**	**1,165**	**100.0%**	**(7.1%)**
營業成本	700	64.7%	695	64.4%	0.7%	757	65.0%	(7.5%)
營業毛利	**382**	**35.3%**	**385**	**35.6%**	**(0.8%)**	**408**	**35.0%**	**(6.4%)**
營業費用	201	18.6%	199	18.4%	1.0%	215	18.5%	(6.5%)
營業淨利	**181**	**16.7%**	**186**	**17.2%**	**(2.7%)**	**193**	**16.6%**	**(6.2%)**
營業外收(支)	(4)	(0.4%)	(8)	(0.7%)	(50.0%)	1	0.1%	(500.0%)
稅前淨利	**177**	**16.4%**	**178**	**16.5%**	**(0.6%)**	**194**	**16.7%**	**(8.8%)**
綜合損益總額	**157**	**14.5%**	**155**	**14.4%**	**1.3%**	**166**	**14.2%**	**(5.4%)**
基本每股盈餘 (NTD)	**1.53**		**1.51**			**1.62**		

合併綜合損益表(年)

DAXIN

Unit：NTD M	2020 前三季		2019 前三季		年成長%
營業收入	**3,263**	**100.0%**	**3,421**	**100.0%**	**(4.6%)**
營業成本	2,095	64.2%	2,261	66.1%	(7.3%)
營業毛利	**1,168**	**35.8%**	**1,160**	**33.9%**	**0.7%**
營業費用	610	18.7%	611	17.9%	(0.2%)
營業淨利	**558**	**17.1%**	**548**	**16.0%**	**1.8%**
營業外收(支)	(5)	(0.2%)	8	0.2%	(162.5%)
稅前淨利	**552**	**16.9%**	**556**	**16.3%**	**(0.7%)**
綜合損益總額	**483**	**14.8%**	**478**	**14.0%**	**1.0%**
基本每股盈餘 (NTD)	**4.71**		**4.65**		

營收與獲利趨勢



註：2020 截至11月自結營收為 3,956M、稅前淨利為 669 M，稅前淨利較去年同期減少 3.2%。

合併資產負債表摘要

DAXIN

Unit: NTD M	2020/9/30		2019/9/30		年成長	年成長 %
現金及約當現金	318	7.6%	93	2.3%	225.0	241.9%
按攤銷後成本衡量之金融資產 - 流動	733	17.6%	502	12.6%	231.0	46.0%
應收帳款	1,259	30.2%	1,410	35.3%	(151.0)	(10.7%)
存貨	263	6.3%	365	9.1%	(102.0)	(27.9%)
不動產、廠房及設備	1,350	32.3%	1,350	33.8%	-	0.0%
使用權資產	192	4.6%	203	5.1%	(11.0)	(5.4%)
資產總計	**4,175**	**100.0%**	**3,993**	**100.0%**	**182.0**	**4.6%**
流動負債	1,077	25.8%	1,186	29.7%	(109.0)	(9.2%)
非流動負債	345	8.3%	196	4.9%	149.0	76.0%
負債總計	**1,423**	**34.1%**	**1,382**	**34.6%**	**41.0**	**3.0%**
權益總計	**2,753**	**65.9%**	**2,610**	**65.4%**	**143.0**	**5.5%**

重要財務指標		
流動比率%	**243%**	**204%**
存貨週轉天數	**36**	**38**

合併現金流量表摘要

DAXIN

Unit: NTD M	2020 前三季	2019 前三季
本期稅前淨利	552	556
折舊及攤銷	166	150
營運資金變動	67	(66)
營業活動之淨現金流入	**720**	**522**
取得不動產、廠房及設備	(170)	(209)
按攤銷後成本衡量之金融資產增加	(203)	(71)
投資活動之淨現金流出	**(375)**	**(281)**
舉借短期借款	-	20
舉借長期借款	159	-
發放現金股利	(514)	(514)
籌資活動之淨現金流出	**(360)**	**(500)**
本期現金及約當現金減少	**(16)**	**(258)**
期末現金及約當現金餘額	**318**	**93**

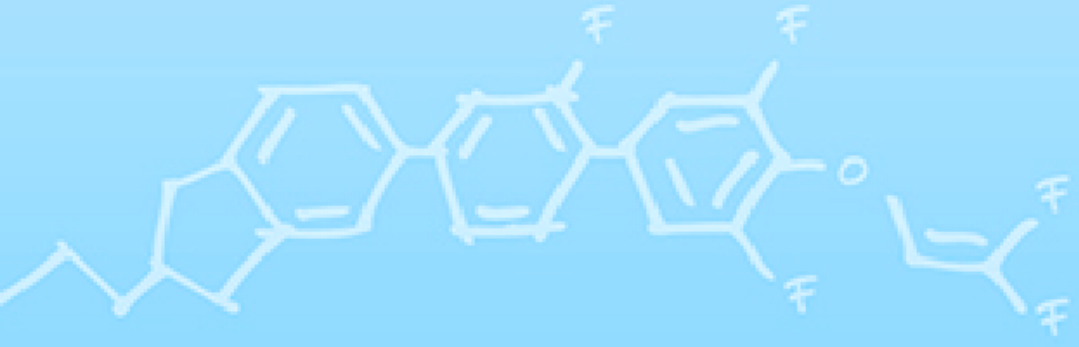
註：2020/9/30及2019/9/30期末現金及約當現金加計超過三個月以上定存餘額分別為1,050M及592M 。

股利政策

DAXIN

■ 維持高股息政策。

年度	EPS	現金股利	股票股利	股利發放比率
2019	6.33	5.0	0.0	79%
2018	6.38	5.0	0.0	78%
2017	5.07	3.5	1.0	89%
2016	3.78	3.0	0.0	79%
2015	2.86	2.0	0.0	70%

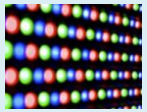


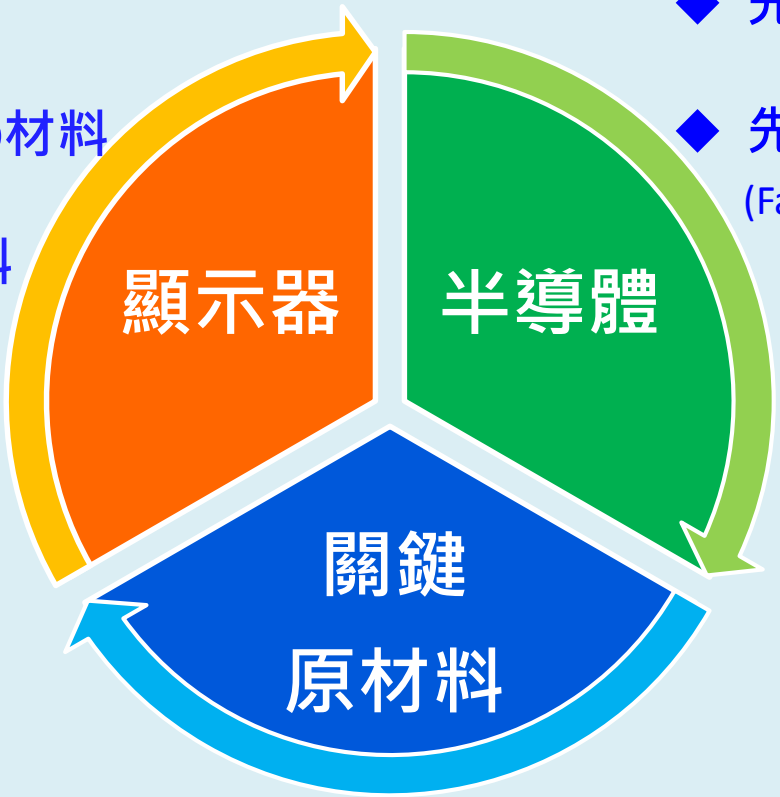
營運概況與未來展望

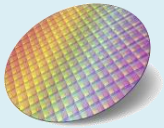
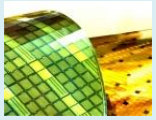
主要產品佈局

DAXIN

- LCD 材料
- OLED, EPD, MicroLED材料
- Foldable 顯示器材料





- 先進製程材料 
- 先進封裝材料 
  (Fan-out, 2.5D, 3D)

- 功能性單體
- 特用高分子

2020 經營成果

DAXIN

顯示器

- LCD PS 間隙材: 導入新客戶，全球市佔 保持領先
- LCD PI 液晶配向膜 : 導入新客戶，持續放量
- LCD 銅蝕刻液 : 導入新世代 8K 銅蝕刻液
- LCD BM 黑色光阻 : 導入新客戶新產線

半導體

- 先進封裝間接材 : 導入新產品
- 先進封裝永久材 : 開發新產品

關鍵原材料

- 功能性單體 : 開發高規格高純度產品

研發計畫 - 顯示器

DAXIN

- 優化生產製程，加速上游關鍵原材料自製，提高競爭力。
- 開發更高規格材料，擴大市佔率。

LCD

- 光配向膜 (UV2A PI)
- 自配向液晶 (PI-less LC)
- 快速液晶 (電競)

Source : Samsung

Foldable/ MicroLED

- 高耐折保護材料
- 次世代製程材料
- 高信賴性封裝材料

Source : Motorola Razr

Source : Playnitride

研發計畫 - 半導體

DAXIN

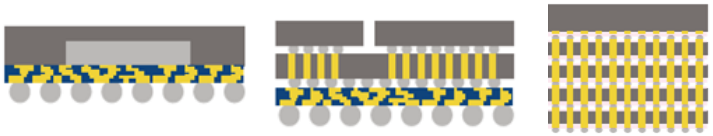
- 開發異質整合新型材料，搭配次世代應用發展。
- 開發低離子原材料之製造技術。

先進封裝

- 高頻低介電低損耗 (Low Dk, Low Df) 感光介電材
- 晶片接著材料

Image credit: JYPIX / Adobe stock photos

Source : JYPIX

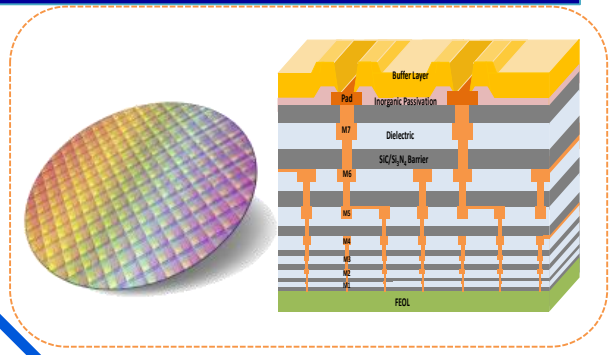


Fan-out　2.5D IC　3D IC

研發計畫 - 關鍵原材料

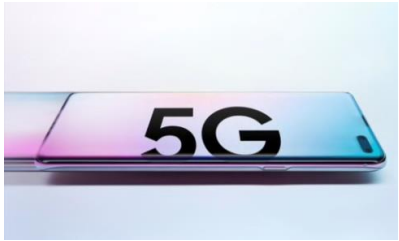
DAXIN

- 強化關鍵原材料分子設計、合成及製造能力，開發各種特殊功能材料。
- 聚焦半導體市場之高端產品。



功能性單體

- 特用密著促進劑
- 超高純度特用添加劑
- 低介電/低損耗關鍵單體



Source : ETtoday

中港新廠

DAXIN

■ 主要產品 ：半導體材料

■ 2020/03 動土

■ 2021下半年 完工啟用

2021 營運重點

DAXIN

顯示器

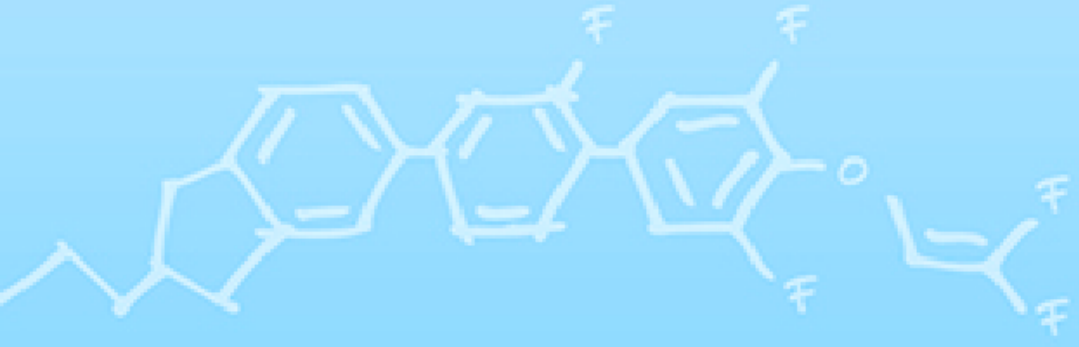
- LCD : 加速上游關鍵原材料自製擴大市佔率
- Foldable/ MicroLED : 開發次世代新型材料

半導體

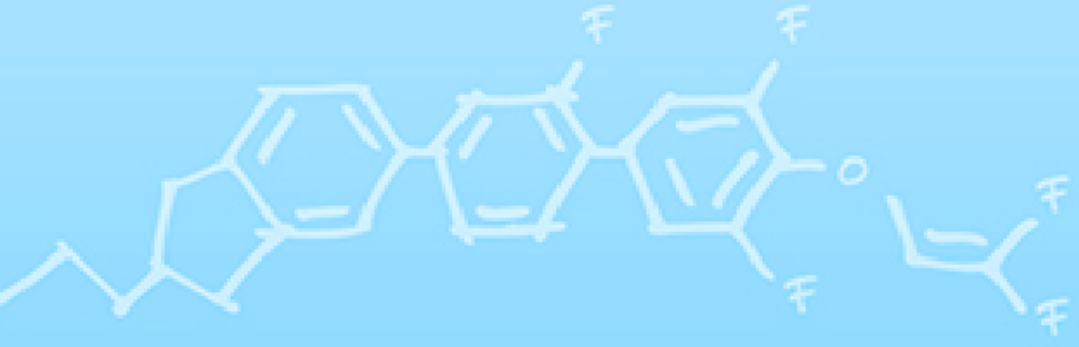
- 先進封裝 : 提供異質整合之材料解決方案
  佈局更高規格新產品開發
  加速永久材之驗證導入

關鍵原材料

- 功能性單體 : 厚植關鍵原材料核心技術能力
  擴大至不同領域之應用



Q & A



Thank you